

奈米中心 Dual E-GUN A 考核記錄表

學校系所:_____ 考試日期:_____ 學號:_____ 姓名:_____

一.筆試:填空題 40% (每空格 2 分)

1. 本機台未開放鍍哪四種汙染較大之材料____,____,____,____。
2. 本機台使用之 CDA 氣體作用為何____及____,PN2 作用為何____。
3. 設備冷卻水最主要提供_____,_____兩個設備冷卻之用。
4. 本機台使用之石英振盪片(Crystal)為__MHz, 低於__MHz 以下需更換。
5. 盛裝鍍料用坩堝依材料不同有區別,目前以使用哪 __,____兩種坩堝為主。
6. 鍍鍋(Holder)以放置____及____尺寸晶片為主,如有其他尺寸或破片須以 真空膠帶黏附於_____再放於鍍鍋上。
7. 抽真空後須待面盤上_____,_____之燈號亮起及抽真空提醒聲響起 後方可確認處於抽真空階段。
8. 檢查真空值時須達_____Torr 以下, 再按 L 鍵回一般的 scal 才可進行後 續操作, 鍍膜期間應避免再按 L 鍵查看, 以免真空值變化過大造成異常 ALARM。
9. 鍍膜 Power supply,主電源開啟後,高電壓值顯示為__KV。

二.實作 60%:

- 1.操作前檢查作業:確認水、電、氣供應,紀錄簿注意事項,使用紀錄填寫及操作標示牌等事項。(10%)

2.各項操作步驟

- 破真空操作及注意事項(5%)
- Gun Body 及腔體清潔細節重點(5%)
- 鍍膜製程參數設定(10%)
- 電子束加熱點控制與鍍料熔融狀態判斷(10%)
- 功率、鍍率、膜厚等操作控制(10%)
- 實驗結束後復歸作為(5%)

3.異常警報及狀況處置(5%)

P.S: (1) 考核及格分數為 80 分。

(2) 通過考核者請向機台系統管理者登錄開卡後方得操作。

分數:_____ 考核員簽名:_____